

9803321-0

Komp's

copy 6



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : G06K 19/077		(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/23843
		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 3. Juli 1997 (03.07.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: ✓ PCT/CH96/00446		(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, CN, CZ, HU, IL, JP, KR, MX, NO, PL, (SG) UA, US, VN, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 19. December 1996 (19.12.96)		
(30) Prioritätsdaten: ✓ 3657/95 ✓ 22. December 1995 (22.12.95) ✓ CH		
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SEMPAC SA [CH/CH]; Hinterbergstrasse 9, CH-6330 Cham (CH).		
(72) Erfinder; und ✓ (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOTTINGER, Werner [CH/CH]; Moosmattstrasse 4, CH-6331 Hünenberg (CH).		
(74) Anwalt: COM PAT AG; Gubelstrasse 17, CH-6300 Zug (CH).		Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.
(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING A CHIP CARD FOR CONTACTLESS OPERATION ✓		
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE FÜR KONTAKTLOSEN BETRIEB		
(57) Abstract		
<p>In the chip cards to be produced, besides the integrated circuit components (chip 2 and/or electronic module 12) and coupling means (coil 6, capacitor coatings 8) for contactless power and/or data transmission there is also at least one label (1) forming the outer surface of the card. The coupling means (6, 8) are applied to the inner side of said label. The label (1), thus prepared, is then inserted into an injection mould. The separately prepared integrated circuit components (12) are then positioned accurately in the mould via terminals in the coupling means (6, 8) and contacted with them. Finally the card body is moulded on the label (1) by the injection moulding process and the integrated circuit components (2, 12) are moulded into the card body. Electric connections between the coupling means (6, 8) and the integrated circuit components (12) are produced in the mould itself by various means.</p>		

(57) Zusammenfassung

Bei den herzustellenden Chipkarten wird ausser den integrierten Schaltungsmitteln (Chip 2 und/oder Elektronikmodul 12) und Kopplungsmitteln (Spule 6, Kondensatorbeläge 8) für kontaktlose Energie- und/oder Datenübertragung mindestens eine Etikette (1) vorausgesetzt, die eine Aussenfläche der Karte bildet. Auf die Innenseite dieser Etikette werden die Kopplungsmittel (6, 8) aufgebracht. Die so vorbereitete Etikette (1) wird dann in eine Spritzgussform eingebracht. Anschliessend werden die separat bereitgestellten integrierten Schaltungsmittel (12) in der Form passgenau über Anschlüssen der Kopplungsmittel (6, 8) positioniert und mit ihnen kontaktiert. Schliesslich werden im Spritzgussverfahren der Kartenkörper an die Etikette (1) angegossen und gleichzeitig die integrierten Schaltungsmittel (2, 12) in den Kartenkörper eingegossen. Elektrische Verbindungen zwischen Kopplungsmitteln (6, 8) und integrierten Schaltungsmitteln (12) werden in der Form selbst durch verschiedene Mittel hergestellt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LX	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauritanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		